**國家中山科學研究院材料暨光電研究所**

**107年度第四次專案人力進用招考甄試簡章**

**壹、員額需求：**

需求全時工作人員研發類20員、技術類20員，共計40員，依「國家中山科學研究院材料暨光電研究所107年度第四次專案人力進用員額需求表」辦理（如附件1）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：新進人員薪資核敘基準表之薪資範圍內，核給基本薪。

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)可申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)軍公教退伍(休)轉任人員，薪資超過法令所訂基準(含主管加給、地域加給)，依法辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

一、國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。

二、學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(持國外學歷者須符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格)。

(一)研發類：

1.碩士(含)以上畢業，其學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。學歷認定以員額需求表所需學歷之畢業證書記載為準，如非理、工學院畢業者，其理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上之規定，可檢具論文、成績單及學校開立證明書認定，或檢具學分證明資料由本院專業單位審查。

2.非理工學院之特殊領域相關系所碩士(含)以上學歷畢業之特殊人才，依本院「特殊領域人才進用作業規定」(如附件2)審認。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

(二)技術類：

1.專科(含)以上畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核 薪。

三、其他限制：具有下列情形之一者，不得辦理進用；若於進用後，本院始查知具下列限制條件者，因自始即未符合報考資格，本院得取消錄取資格，並不得提出異議︰

(一)大陸地區人民、香港居民或澳門居民。

(二)無行為能力或限制行為能力者。

(三)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告者。

(四)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(五)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(六)因案被通緝或在羈押、管收中。

(七)依法停止任用者。

(八)褫奪公權尚未復權者。

(九)受監護宣告尚未撤銷者。

(十)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣者。

(十一)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十二)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之懲罰者。

**肆、報名時間及方式：**

一、甄試簡章刊登於本院全球資訊網(<http://www.ncsist.org.tw>)

，公告日期至107年8月3日止。

二、 符合報考資格者，需至本院網路徵才系統(https://join.ncsist.org.tw)填寫個人資料及上傳履歷表(貼妥照片，格式如附件3)、學歷、經歷、成績單、英文檢定證明、論文、期刊發表、證照、證書等相關資料後，選擇報考職缺並投遞履歷，各項資料並依序彙整在同一檔案(PDF檔)上傳。

三、需求單位於本院徵才系統資料庫搜尋並篩選符合報考資格者後

，辦理書面審查(或資格審查)。

四、報考人員經書面審查 (或資格審查)合格者，需求單位以電子郵件、書面或簡訊(可擇一)通知參加甄試。

五、不接受紙本及現場報名甄試。

六、若為年度應屆畢業生或延畢生(報名甄試時尚未取得畢業證書者)，報名時得先不繳交畢業證書掃描檔，但需繳交學生證掃描檔查驗。前述人員錄取後，需於本院寄發通知日起3個月內(報到前)繳驗畢業證書，若無法於時限內繳驗，則取消錄取資格。

七、歡迎具身心障礙身分或原住民族身分，且符合報考資格者報名參加甄試，並於人才資料庫登錄資料時註記。

八、為提供本院聘雇員工職類轉換管道，本次招考開放院內符合報考資格之員工，可報名參加甄試。本院員工報名甄試者，不可報考同一職類，且需經單位一級主管同意後(報名申請表如附件4)，於本院網路徵才系統完成報名。另當事人需填具工作經歷(非職稱)後，由該工作經歷任職單位二級主管核章，無需檢附勞保明細表。

**伍、報名應檢附資料：**報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。**各項資料依序彙整於同一檔案上傳。**

一、履歷表(如附件3），並依誠信原則，確實填寫在本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，本院**得**予不經預告終止契約解除聘雇。

二、符合報考學歷之畢業證書掃描檔。

三、報考所需之個人掃描檔資料(如：工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等，請參考簡章之員額需求表)。

四、提供工作經歷證明者，格式不限，但需由公司蓋章認可，內容需註明從事之工作內容(非職稱)及任職時間。

五、若有繳交民營機構之工作經歷證明，需再檢附「勞保明細表」，未檢附勞保明細表者，該工作經歷不予認可。

六、 具身心障礙身分者，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面**掃描檔**。

七、具原住民族身分者，檢附戶口名簿或戶籍謄本**掃描檔**，並標記族別。

八、主管核章之申請表**掃描檔**(僅本院同仁需繳交)。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

一、甄試日期及時間：暫定107年 8月 (實際甄試時間以甄試通知為準)。

二、甄試地點：暫定本院新新或龍門院區(桃園市龍潭區)(實際甄試地點以甄試通知單為準)。

三、甄試方式： (實際甄試方式以甄試通知為準)

(一)研發類：

1.初試：甄試科目及配分請參閱員額需求表。

2.通過初試者視需於複試前參加性格特質測驗。

3.複試：口試作業。

(二)技術類：

1.甄試科目及配分請參閱員額需求表。

2.項次23筆試參考書籍請參照員額需求表甄試方式。

3.複試：口試作業。

**柒、錄取標準：**

一、甄試合格標準：

(一)初試單項(書面審查/實作/筆試/口試)成績合格標準請參閱員額需求表，未達合格標準者不予錄取。

(二)複試(口試)合格標準為70分(滿分100分)。

(三)初、複試總成績合格標準為70分(滿分100分)。

(四)如有其中一項甄試項目缺考者，不予計算總分，且不予錄取。

二、成績排序：

(一)以總成績高低依序錄取：

研發類、技術類：總成績為複試(口試)平均成績。

(二)總成績相同時：

1.研發類：依序以初試總成績、口試平均成績、書面審查平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由需求單位決定錄取順序。

2.技術類：依序以初試總成績、口試平均成績、實作平均成績/筆試成績、書面審查平均 (若採二者併行，則依序以實作平均成績為優先，筆試成績次之)；遇所有成績均相同時，由需求單位決定錄取順序。

三、備取人數及儲備期限：

(一)備取人數以2員為限。

(二)備取人員儲備期限自甄試結果奉權責長官核批次日起4個月內有效。

**捌、錄取通知：**

一、甄試結果預由本院於甄試後一個月內寄發通知單(或以電子郵件通知)，各職缺錄取情形不予公告。

二、人員進用：錄取人員參加權利義務說明會後，再辦理報到作業。錄取人員試用3個月，試用期間經考核為不適任人員，予以資遣並核予資遣費。

三、人員錄取或遞補後，其他招考職缺之錄取或遞補皆需自動放棄。

**玖、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員：**

總機：(03)4712201或(02)26739638

聯絡人及分機：材料暨光電研究所 陳彥良組長 分機357010

黃瑞婷小姐 分機357231

劉佳珊小姐 分機357268

line@帳號：@rcd1239e

如有報考相關問題，請加入line@官方帳號，歡迎線上提問。

附件1

| **國家中山科學研究院材電所107年第四次專案人力進用員額需求表** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作編號** | **需求**  **單位** | **職類** | **學歷**  **需求** | **薪資**  **範圍** | **專長**  **(技能)** | **學歷、經歷條件** | **工作內容** | **需求**  **員額** | **工作**  **地點** | **甄試**  **方式** |
| **1** | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 雷射/光電系統 | 1.電子/電機/光電/物理等相關系所畢業。  2.具工作內容相關工作技術經驗之一者為佳(請檢附證明資料)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士、博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.固態/光纖雷射研製。  2.光電系統設計與整合。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **2** | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 材料 | 1.材料/機械/航空等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)金屬方向性凝固模擬及熱場分析。  (2)方向性凝固空心葉片散熱流道用陶芯設計開發。  (3)金屬方向性凝固鑄造相關研發或製造。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士、博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.金屬方向性凝固模擬及熱場分析。  2.方向性凝固空心葉片散熱流道用陶芯設計開發。  3.金屬方向性凝固鑄造技術及製程開發。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **3** | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 材料 | 1.材料/化學/高分子等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件為佳(請檢附相關證明)：  (1)曾論文發表或從事樹脂配方開發與改質經驗者。  (2)曾於學校、國內外公司負責或參與高分子複合材料開發經驗者。  (3)具熱分析儀器使用經驗(DSC、DMA、RDS及TGA等)  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士、博士論文摘要、發表論文第一頁等影本。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.高分子材料合成  2.熱固或熱塑性樹脂配方開發  3.高分子複合材料設計開發。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 4 | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 電子/電力 | 1.電子/電機/資訊/控制/電信/通訊/機電/動力機械/應用化學等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)電子電路設計。  (2)交/直流電力轉換。  (3)具Labview/PLC開發經驗。  (4)具軟體通信與數位訊號處理工作經驗。  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士、博士論文摘要、發表論文第一頁等影本。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.再生能源/儲能系統電源管理。  2.智慧電網調控技術。  3.燃料電池人機介面控制程式設計。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **5** | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械 | 1.機械/動力機械/應用力學/航空/光電等相關理工系所畢業。  2.具工作內容相關工作技術經驗之一者為佳(請檢附證明資料)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.負責光電產品機構設計與熱傳分析、機電整合與系統測試，能導入專案開發過程至量產。  2.熟Solidworks或Pro/E等2D/3D軟體操作者為佳。  3.機械/結構設計、靜力與動態分析。  4.各式模治具設計開發。  5.負責產品製程規劃、界面協調、技術資料整建、專案計畫管制等。 | 1員 | 桃 園  龍 潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **6** | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機/控制工程 | 1.電子/電機/控制/機械等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)微處理器/DSP應用數位電路開發。  (2)微處理器及DSP韌體程式開發及測試。  (3)FPGA Verilog 或VHDL程式開發。  (4)WINDOWS/Android/ RTOS作業系統等程式軟體開發。  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.微處理器/DSP電路設計與測試。  2.微處理器及DSP韌體程式開發及測試。  3.作業系統核心程式開發。  4.光電數位信號處理或嵌入式系統開發。  5.訊號處理演算法開發及程式驗證。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **7** | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/資訊/通訊/機械/動力機械等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)類比電路分析設計、佈線、測試除錯，SPICE電路模擬  (2)機電系統整合、測試、分析與除錯。  (3)光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.類比電路分  析設計、佈  線、測試除  錯，SPICE電  路模擬。  2.光電轉換訊  號放大/電源  系統等類比  電路開發。  3.機電系統整  合、測試、分  析與除錯。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **8** | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/資訊/通訊/機械/動力機械等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)微處理器/DSP應用電路開發與測試。  (2)數位電路設計與測試。  (3)光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。  (4)微處理器/DSP軔體程式開發及測試。  (5)FPGA Verilog/VHDL韌體程式設計開發。  (6)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.微處理器/DSP應用電路開發與測試。  2.數位電路設計與測試。  3.光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。  4.Verilog/VHDL影像追蹤韌體程式設計。  5.視訊訊號介面轉換設計。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **9** | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機/光電 | 1.電子/電機/光電等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)具機光電元件與系統組、調、測等流程規劃及執行相關工作經驗為佳。  (2)具機電整合、光電量測、系統電路檢測、機電接頭佈線等相關工作經驗為佳  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.光電元件與系統組、調、測等流程規劃及執行。  2. 機電整合、光電量測、系統電路檢測、 機電接頭佈線等。  3.光電系統設計及光學場景特性之研析。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **10** | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/動力機械/應力/航空 | 1.機械/動力機械/應用力學/航空等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)具機構設計相關工作經驗為佳。  (2)具結構及熱傳分析ANSYS軟體，2D/3D SolidWorks繪圖軟體操作能力為佳。  (4)具機構設計相關工作經驗為佳。  (5)具各式模治具設計開發相關工作經驗為佳。  (6)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.機構設計。  2.結構及熱傳分析ANSYS軟體，2D/3D SolidWorks繪圖軟體操作。  3.機械/結構設計、靜力與動態分析。  4.各式模治具設計開發。  5.可配合加班及出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 11 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 光電/電子/電機/物理/機械 | 1.電子/電機/光電/物理/機械等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)具可見光攝影機、熱像機、雷射測距儀及光電觀測系統等設計、組調與測試相關工作經驗。  (2)具離軸拋物面鏡光學系統調校與測試相關工作經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.光電觀測系統性能量測設備架設。  2.光電觀測系統組調與測試。  3.光電觀測系統異常問題研判及故障排除，系統精進研改規劃。  4.光電觀測系統環境測試與功性能驗證。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 12 | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 光電/影像/機器視覺系統 | 1.光電/物理/電子/電機/機械等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)光電影像系統設計及應用  (2) VR/AR或機器視覺相關系統或產品開發經驗。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)博士論文摘要、發表論文第一頁等影本。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.光電影像系統開發。  2.光電系統整合、AR擴增實境產品應用。  3.低光度影像系統分析設計與應用。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 13 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 材料 | 1.材料/電子/電機等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與其它有助審查資料之文件(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)黃光微影製程。  (2)乾/濕式蝕刻、金屬蒸鍍等製程。  (3)元件特性量測。 | 執行半導體元件製程工作，包含：黃光微影製程、乾/濕式蝕刻、金屬蒸鍍等製程與元件特性量測工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 14 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/資訊/控制/電信/通訊/光電/物理等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)fully-custom 或cell-cell IC design。  (2)熟hspice、icfb laker、verilog、design compiler、prime time、astro/ICC、calibre或其他EDA tool。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | ASIC、類比/數位積體電路設計開發與驗測。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 15 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 材料/光電/電機/電子 | 1.材料/光電/電機/電子/物理/化學等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)半導體無塵室製程經驗。  (2)元件特性量測。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.黃光微影製程。  2.乾/濕式蝕刻製程。  3.鍍膜製程。  4.元件特性量測。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 16 | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械 | 1.機械/應用力學/造船/航空/機電/材料等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明文件)：  (1)具力學模擬分析、Solidworks或 Catia設計相關軟體工作經驗。  (2)具機械/結構設計、振動與動態分析與量測相關工作經驗。  (3)具各式模治具設計開發相關工作經驗。  (4)具機械類加工製造、檢驗與品管工作經驗。  (5)曾執行複材結構設計、分析與製作開發等相關工作經驗。  (6)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 1.複合材料結構開發與研製。  2.複合材料製程設計開發。  3.複合材料結構設計分析與測試技術研究。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 17 | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 材料 | 1.材料/機械/模具等相關理工科系畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)機械加工機具操作及維護。  (2)大型機具如熱壓機等操作維護。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.複合材料製作。  2.機械加工及機具維護。  3.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.機械圖視圖能力  2.按照施工圖執行預浸布裁切/疊貼、空壓機具操作能力  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 18 | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 材料 | 1.材料/化學工程等相關理工科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.有橡膠膠合成型或預浸料製作經驗為佳。 (請檢附相關證明)：  (1)預浸料製作製程。  (2)複合材料製程。  (3)橡膠膠合、成型製程。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.軟質橡膠黏貼成型。  2.預浸料製作。  3.複合材料試片製作。  4.配合工作需求，需於桃園龍潭及新北三峽兩地工作。  5.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.預浸料裁切  2.複合材料試片熱壓成型  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 19 | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 材料/化工 | 1.材料/化學等相關科系畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)材料分析設備操作經驗。  (2)金相試片製備經驗。  (3)材料合成技術。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.金相製備、微觀組織觀察分析。  2.材料檢測分析設備操作。  3.材料合成技術的開發。  4.相關行政事務支援。  5.可配合輪班、 調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%：**  金相製備及顯微鏡操作  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 20 | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 電子/電機/機電 | 1.電子/電機/機電等相關科系畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附證明資料)：  (1)需檢附大學(含)以上各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  (2)1年(含)以上機電整合、電路板檢測、佈線圖繪製、接頭佈線等相關工作經驗為佳。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.執行光電模組製作及測試、線路圖繪製與佈線配接、機台操作與維護工作。  2.檢測裝備操作、示波器量測、訊號模擬與量測、電子設備檢修。  3.電路板焊接、 組裝及測試。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%：**  1.電子電路錫焊與配線。  2.示波器或電表等基本儀器操作。  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 21 | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 機械 | 1.機械/電子/電機/光電/化學等相關科系畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具工作內容相關工作技術經驗之一者為佳(請檢附證明資料)：  (1)封裝製程操作及封裝技術開發。  (2)模組環境試驗的相關作業。  (3)熟Solid Works或Pro/E等2D/3D軟體操作者為佳。 | 1.封裝製程操作及封裝技術開發。  2.模組環境試驗的相關作業。  3.熟Solid Works或Pro/E等2D/3D軟體操作者為佳。  4.行政事務支援。  5.生管工作。  6.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃 園  龍 潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%**  1.工程圖研判  2.封裝實作  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 22 | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  42,000 | 光電/電機/資工 | 1.電子/電機/光電/機電/資工/資訊/工業工程/工業系統/系統工程等理工相關科系畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)程式編寫、偵錯。  (2)資料庫系統操作及運用。  (3)電子、電機、光電量測、電路板檢測、焊接、接頭佈線等相關工作經驗為佳。  (4)孰悉Office Word、Excel、Powerpoint等相關作業軟體。  (5)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (6)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.PIC/DSP或8051微處理器軔體程式開發及測試  2.Labview或C# 人機介面開發及測試  3.檢測裝備操作、示波器量測、訊號模擬與量測、電子設備檢修。  4.行政事務支援。  5.生管工作。  6.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%：**  程式語言(C#或Labview)  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 23 | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 採購管理/物料管理 | 1.理工相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.曾任職2017或2018天下雜誌2000大企業採購業務為佳。  4.具有全民英檢中高級/托福iBT 72以上/TOEIC 750以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  5.熟ORACLE資料庫或Access 軟體操作為佳。 | 1.生產製程排程、工令與進度管制，生產管理等相關工作。  2.財產管理、物品管理、物料管理、物流管理等相關工作。  3.料件籌購、商情分析、產業資料蒐整分析、購案作業、驗收結報等相關工作。  4.物料系統操作及物料管理等相關工作。  5.可配合輪班、  調班、出差。 | 5員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加筆試及口試)  **筆試30%：**  撰寫購案指定廠商採購之評估報告  參考書目:  政府採購法，出版社:公共工程委員會  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 24 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 材料 | 1.材料/機械/模具/電子等相關理工科畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)材料與機械加工。  (2)非破壞檢測證照。  (3)材料、製程、夾模治具開發。  (4)複合材料製程。  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.複合材料製作與加工。  2.複合材料非破壞檢測。  3.製程夾模治具設計與開發。  4.配合工作需求，需於桃園龍潭及新北三峽兩地工作。  5.可配合輪班、  調班、出差。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.壓力釜成型包裝作業  2.按照施工圖執行預浸布裁切/疊貼  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 25 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 材料 | 1.材料/機械/電機等相關理工科系畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)具銲接、熱處理、硬銲、金屬加工製程。  (2)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.雷射銲接及其它熔融銲接製程開發工作。  2.真空硬銲及真空熱處理製程開發工作。  3.陶瓷與金屬接合製程開發工作。  4.鋁合金熱處理製程開發工作。  5.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  填料塗佈  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 26 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 機械/材料/化工 | 1.機械/材料/化學工程等相關理工科系畢業  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)車、銑床、磨床、焊接等機械加工。  (2)機械製圖、組裝、膠合與檢測。  (3)複材製作與材料機械性質量測。  (4)高溫、高壓容器與高壓氣體特定設備  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.車、銑床、磨床、焊接等機械加工，包括工件、夾治具製作、尺寸檢測。  2.機械製圖、組裝、膠合與檢測及機械性質量測。  3.複材製作、高壓熔滲、碳化、石墨化與燒結製程相關設備操作與保養維護。  4.相關行政事務支援。  5.配合工作需求，需於桃園龍潭及新北三峽兩地工作。  6.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 新北  三峽 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%：**  機械製圖  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 27 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  45,000 | 材料/鑄造/機械/電機 | 1.材料/鑄造/機械/電機/模具等相關理工科系(組)畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)機械/材料/鑄造相關工作經驗一年以上，或具相關之技術士執照或曾於相關專業訓練機構結訓者(請檢附相關證明或證照影本)。  (2)電機或設備維修相關工作經驗1年以上，或具相關之技術士執照或曾於相關專業訓練機構結訓者(請檢附相關證明或證照影本)。  (3)天車及堆高機操作執照。 | 執行砂模或精密鑄造之熔鑄或製模等製程工作，包含：準備材料、熔鑄、造模、後處理等製程相關設備之操作與基本維護、檢修等。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%**  1.鑄造模型製作及鑄後處理。  2.設備維修實務及電表操作、量測。  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 28 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 電子/電機/機電 | 1.電子/電機/機電等相關科系畢業。  2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：：  (1)儀具量測操作。  (2)電路板檢測、焊接、佈線等相關工作。  (3)LabView/C程式編寫相關工作。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.儀具裝備操作、量測、檢修。維護。  2.電路板檢測、焊接、佈線。  3.測試程式與人機介面開發。  4.環境測試與功性能驗證。  5可配合輪班、調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%：**  1.電子電路錫焊與配線。  2.示波器或電表等基本儀器操作。  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 29 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關科系畢業。  2.需檢附專科各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.鉛作業特殊體格檢查合格(需檢附相關證明)。  4.報到時需檢附鉛作業特殊體格檢查合格體檢表，如未檢附者視同資格不符。  5.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附證明資料)：  (1)1年(含)以上機電整合、光電量測、電路板維修、機電接頭佈線、電路板布局等相關工作經驗為佳。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.執行光電模組製作及測試、線路配接、機台操作與維護工作。  2.影像電路板訊號檢修。  3.檢測裝備操作、示波器量測、訊號模擬與量測、電子設備檢修。  4.電路板布局(熟悉Altium 、Allegro、PADS等軟體)及布局系統維護。  5可配合輪班、調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，  未達合格標準者，不通知實作及口試)  **實作30%：**  1.電子電路錫焊與配線。  2.示波器或電表等基本儀器操作。  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 30 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業。  2.需檢附專科各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：  (1)精密機械加工(車、銑床)  (2)精密機械組裝及檢測  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.車、銑床、精密CNC加工，包括夾治具製作、尺寸檢測、鏡頭組裝等。  2.可配合輪班、    調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.機械藍圖視圖能力。  2.按照藍圖需求，選用適當的加工方式並詳細說明製造程序。  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 31 | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 電子/電機/光電/機電 | 1.電子/電機/光電/機電等相關科系畢業。  2.需檢附專科各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附證明資料)：  (1)需檢附專科(含)以上各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  (2)1年(含)以上機電整合、光電量測、電路板檢測、接頭佈線等相關工作經驗為佳。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.執行光電模組製作及測試、線路配接、機台操作與維護工作。  2.檢測裝備操作、示波器量測、訊號模擬與量測、電子設備檢修。  3.電路板焊接、 組裝及測試。  4.可配合加班 及出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.電子電路錫焊  2.示波器或電表等儀器操作  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 合計：研發類20員、技術類20員，合計40員 | | | | | | | | | | |

附件2

國家中山科學研究院特殊領域人才進用作業規定

一、特殊進用適用對象

非理工科系之特殊領域相關科系碩士(含)以上學歷：大學及碩士修滿與特殊領域相關課程24學分且具備特殊領域證照、競賽得名或特殊技能者，得報名參加本院公開招考。

二、相關專業證照、競賽性質、特殊技能等採計條件如附表

附表-特殊領域限制條件採計表

| 特殊領域 | 限制條件 | 內容 | 採計  審認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資訊安全 | 資訊管理或應用相關科系碩士(含)以上學歷 | 大學及碩士須修滿與資訊學科相關課程24學分。 | 相關證照、競賽性質、資安技能認定及科技技術年資採計，有疑義由資訊通信研究所及資訊管理中心共同成立審查小組審認之。 |
| 資安國際證照(本項適用對象須具備右列證照至少一項，且證照有效期必須超過招考報名截止日期) | (1)ISO 27001之資訊安全管理系統主導稽核員認證  (2)ECSA 資安分析專家認證  (3)EDRP 資安災害復原專家認證  (4)CCISO 資安長/EISM資安經理人認證  (5)CISSP 資訊安全系統專家認證  (6)CSSLP 資訊安全軟體開發專家認證  (7)CCIE Security 認證  (8)RHCA Red Hat Linux系統安全調校認證  (9)LPT 滲透測試專家認證  (10)Guidance EnCase 國際專業鑑識認證  (11)CHFI 資安鑑識調查專家(數位鑑識) |
| 國際重要資安競賽(本項適用對象須具備右列2年內國際資安競賽獲得前10名(含)至少一項) | (1)Defcon CTF Qualifier  (2)Plaid CTF  (3)Boston Key Party CTF (BKPCTF)  (4)HITCON CTF  (5)Hack.lu CTF  (6)RuCTFe |
| 資安特殊技能 | (1)對資訊安全領域有重要成就或傑出表現(如挖掘重要資訊系統弱點，經正常管道提報，避免重大損害)。  (2)曾於Defcon、BlackHat國際重大論壇發表論著。  (3)曾挖掘零時差弱點於HITCON ZERODAY或Vulreport經審認發表。 |
| 軟體開發與管理 | 軟體開發與管理相關國際證照(本項適用對象須具備右列證照至少一項，且證照有效期必須超過招考報名截止日期) | (1)OCM：Oracle Certified Master  (2)Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)  (3)Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)  (4)Red Hat Certified Engineer(RHCE)  (5)Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop(CCAH)  (6)Cloudera Certified Professional (CCP Data Engineer)  (7)Certified Software Quality Engineer(CSQE)  (8)Certified Software Testing Engineer(CSTE)  (9)ERP軟體顧問師(ERP Software Consultant)  (10)進階ERP規劃師(Advanced ERP Planner)  (11)ERP導入顧問師(ERP Implementation Consultant)  (12)OMG Certified UML Professional (OCUP) Advanced  (13)Certified CMMI for Development Supplement Instructor  (14)Certified CMMI Professional  (15)BI 企業顧問師(BI Enterprise Consultant)  (16)BI 軟體顧問師(BI Software Consultant)  (17)BI企業績效管理顧問師(BI performance Management Consultant) | 相關證照認定及科技技術年資採計，有疑義由資訊通信研究所或資訊管理中心成立審查小組審認之。 |

三、一般事項

(一)相關證照、競賽性質、特殊技能認定及科技技術年資採計，有疑義由提出之專業單位成立審查小組審認。

(二)如特殊領域牽涉範圍超出單一專業，則有疑義由提出之專業單位主辦，召集相關單位共同成立審查小組審認。

附件3

**履　　　　　歷　　　　　表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名 | |  | | ★身分證  號碼 | | | | |  | | | | 最近三個月  1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | | 年月日 | | 婚姻 | | | | | □已婚 □未婚 | | | |
| ★兵役狀況 | | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) | | | | | | | | | | | | |
| ★電子郵件 | |  | | | | | | | | | | | | |
| ★通訊處 | 戶籍  地址 |  | | | | | | | | | | 行動電話 | | |  |
| 通訊  地址 |  | | | | | | | | | | 連絡電話 | | |  |
| 居住國外在台聯絡人員  (緊急聯絡人) | |  | | 行動電話 | |  | | | | | 連絡電話 | | |  |
| ★  學歷 | 學校名稱 | | | | 院系科別 | | | | 學位 | | | 起迄時間 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★  經歷 | 服務機關名稱 | | | | 職稱(工作內容) | | | | | | | | 起迄時間 | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 家庭狀況  ★ | 稱謂 | 姓名 | | | 職業 | | | | | 服務機關 | | | 連絡(行動)電話 | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三親等親屬及朋友  在中科院任職之  ★ | 關係(稱謂) | | 姓名 | | | | | 單位 | | | | | | 職稱 | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | | | | 體重：　　 　　　公斤 | | | | | | | | 血型： 　　　型 | | |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | | | | | | | | 族 別：　　　 　　　　　族 | | | | | |
| 身心  障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | | | | | | | | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) | | | | | |

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 簡要自述(請以1頁說明) |
|  |

(本表若不敷使用請自行延伸)　　　　　　　　　　填表人：　　　 　　　（簽章）

(提醒：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個PDF檔案上載)

**依進用員額需求表學歷、經歷條件需求資料，依序自行增修**

一、畢業證書(符合報考職缺學歷要求之畢業證書及最高學歷畢業證書)

(請貼上畢業證書圖檔)

二、學歷文件(大學成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上大學成績單圖檔)

三、學歷文件(碩、博士成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上碩、博士成績單圖檔)

四、英文測驗證明文件(本項視報考工作之編號學歷、經歷條件需求，如全民英檢、多益、托福…等)

(請貼上英文證明文件圖檔)

五、具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)或其它相關證照(本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上證照正反面圖檔)

六、相關專業工作經歷證明(本項視學歷、經歷條件需求，本項需公司開出之證明文件)

(請貼上工作經歷證明圖檔)

七、其它補充資料或特殊需求(本項視學歷、經歷條件需求，或補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)

附件4

**國家中山科學研究院**

**各類聘雇員工參加招考報名申請表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現職單位  （至二級） | | 姓名  (身分證號碼) | 職類及級職 | 最高學歷  (含科/系/所) | |
|  | |  |  |  | |
| 擬參加甄選單位職缺 | | | | | |
| 報考單位(或工作編號) | | | 職類 | | 職缺 |
|  | | |  | |  |
| 本人簽章 | 二級單位 | | 一級單位主管批示 | | |
| 電話： |  | |  | | |
| 一級人事單位 | |
|  | |

備註：非本院現職員工免填。